

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成23年7月14日(2011.7.14)

【公開番号】特開2009-283777(P2009-283777A)

【公開日】平成21年12月3日(2009.12.3)

【年通号数】公開・登録公報2009-048

【出願番号】特願2008-135796(P2008-135796)

【国際特許分類】

H 01 L 21/822 (2006.01)

H 01 L 27/04 (2006.01)

H 01 L 29/786 (2006.01)

G 06 K 19/07 (2006.01)

G 06 K 19/077 (2006.01)

【F I】

H 01 L 27/04 U

H 01 L 27/04 L

H 01 L 27/04 H

H 01 L 29/78 6 1 3 Z

G 06 K 19/00 H

G 06 K 19/00 K

【手続補正書】

【提出日】平成23年6月1日(2011.6.1)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

互いに対向するように設けられた第1の絶縁体及び第2の絶縁体と、
前記対向する第1の絶縁体と第2の絶縁体との間に設けられた半導体集積回路及びアンテナと、

前記第1の絶縁体及び前記第2の絶縁体の前記半導体集積回路と反対側の表面にそれぞれ
設けられた導電性遮蔽体とを有し、

前記第1の絶縁体及び前記第2の絶縁体の少なくとも一方は、纖維体に有機樹脂が含浸さ
れた構造体を有することを特徴とする半導体装置。

【請求項2】

互いに対向するように設けられた第1の絶縁体及び第2の絶縁体と、
前記対向する第1の絶縁体と第2の絶縁体との間に設けられた半導体集積回路及びオンチップアンテナと、

前記第1の絶縁体及び前記第2の絶縁体の前記半導体集積回路と反対側の表面にそれぞれ
設けられた導電性遮蔽体と、

前記オンチップアンテナと電磁結合するブースターアンテナとを有し、

前記第1の絶縁体及び前記第2の絶縁体の少なくとも一方は、纖維体に有機樹脂が含浸さ
れた構造体を有することを特徴とする半導体装置。

【請求項3】

請求項2において、

前記半導体集積回路は前記ブースターアンテナを介して外部と無線通信を行うことを特徴

とする半導体装置。

【請求項 4】

請求項 1 乃至 3 のいずれか一項において、

前記導電性遮蔽体は積層構造であることを特徴とする半導体装置。

【請求項 5】

請求項 1 乃至 4 のいずれか一項において、

前記導電性遮蔽体は、金属膜を有すること特徴とする半導体装置。

【請求項 6】

請求項 1 乃至 4 のいずれか一項において、

前記導電性遮蔽体は、金属酸化膜、金属窒化膜、又は半導体膜を有することを特徴とする半導体装置。

【請求項 7】

請求項 1 乃至 6 のいずれか一項において、

前記第 1 の絶縁体及び前記第 2 の絶縁体の少なくとも一方の厚さは、 $5 \mu m$ 以上 $50 \mu m$ 以下であることを特徴とする半導体装置。